



平成22年7月29日

各位

上場会社名 TOWA株式会社
 代表者 代表取締役社長 西村 永和
 (コード番号 6315)
 問合せ先責任者 執行役員 管理本部長 岸本 昌利
 (TEL 075-692-0251)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成22年5月13日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成23年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	10,000	500	450	400	15.99
今回発表予想(B)	12,000	1,900	1,900	1,900	75.96
増減額(B-A)	2,000	1,400	1,450	1,500	
増減率(%)	20.0	280.0	322.2	375.0	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成22年3月期第2四半期)	5,831	△867	△1,037	△979	△39.15

平成23年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	9,500	350	300	250	10.00
今回発表予想(B)	11,800	1,800	1,800	1,800	71.96
増減額(B-A)	2,300	1,450	1,500	1,550	
増減率(%)	24.2	414.3	500.0	620.0	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成22年3月期第2四半期)	5,607	△947	△898	△769	△30.74

修正の理由

平成23年3月期第1四半期における半導体市場は、昨年のマイナス成長の反動を大きく受け、パソコンや多機能携帯電話等の電子機器が半導体需要を大きく牽引し、非常に好調な状況が続きました。製造装置向けの投資では、アジア地域、とりわけ中国市場における半導体の需要増加が見込まれることから、各半導体メーカーが本格的な量産投資に踏み切ったことにより想定を上回る水準で市況が回復いたしました。このような状況のもと当社グループは、急増する受注に対応するため増産体制をとり、固定費の増加は最小限に抑えたいうで生産キャパアップを実施いたしました。また、海外生産拠点からの直出荷体制を整え、短納期対応にも万全を期してまいりました。その結果、第1四半期における売上高および営業利益、経常利益、四半期純利益が当社計画を上回ることが見込まれ、足もとの受注動向も引き続き堅調であることから、上記のとおり第2四半期累計期間の業績予想を修正することといたしました。尚、通期の業績予想については精査中であり、配当予想とあわせて決定次第、速やかに開示する方針です。

(注)将来の事象に係る記述に関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により予想と異なる場合があります。

以上